

The background of the slide features a blue grid pattern with glowing lines and squares. On the left side, there are images of industrial equipment, including a large machine with a control panel and a smaller device with a screen. The text "先進設備科技 整合领航者" is written in a stylized font with a red outline and a drop shadow.

先進設備科技 整合领航者

京鼎精密科技

法人說明會

2020/4/23

■ 公司營運概況

呂軍甫

發言人

◆ 公司簡介

◆ 競爭優勢及發展策略

◆ 營運實績

■ 問與答

邱耀銓

總經理

陳鎮福

財務長

呂軍甫

發言人

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測資訊。本公司未來實際所可能發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司無法掌控之風險因素。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。
- 本公司並未作任何明示或暗示聲明或保證，請勿仰賴本資料中所呈現或所包含之資訊之正確性、公正性或完整性。本資料不構成證券發行邀約。

01



公司簡介

02



競爭優勢及發展策略

03



營運實績

Foxsemicon



成立日期：2001年4月26日

上市日期：2015/7

新台幣8.27億元

董事長：劉揚偉

總經理：邱耀銓

主要營業項目

■半導體設備、模組及關鍵性零組件之製造及銷售

■自動化設備之研發、製造及銷售，提供整合性解決方案

【營業總部】

台灣竹南科學園區
京鼎精密科技公司



【製造中心】

中國上海
上海富士邁



【製造中心】

中國江蘇
昆山富曜



【業務中心】

美國加州 San Jose & 德州 Austin
Foxsemicon Integrated Technology Inc.



2001-2005

2001

沛鑫半導體工業股份有限公司設立

2002

通過世界第一大半導體設備製造商之合格供應商認證，開始量產

2003

新竹科學工業園區營運總部新廠落成

2005

上海製造中心落成正式量產

2006-2015

2007

天下雜誌調查2006年臺灣1000大製造業第578名，半導體產業中名列第57名

2012

榮獲符合經濟部工業局自動化技術服務機構服務能量作業登錄重點公司

2013

榮獲世界第一大半導體設備製造商最佳品質及準時達交供應商評鑑獎

更名為京鼎精密科技股份有限公司

2014

通過ISO-13485認證跨入醫療設備產業

2015

於臺灣證券交易所掛牌上市

2016~

2016

榮獲世界第一大半導體設備製造商「最佳服務合作獎」

2017

榮獲世界第一大半導體設備製造商「最佳合約製造獎」及「全球服務快速發展優良表現獎」

2018

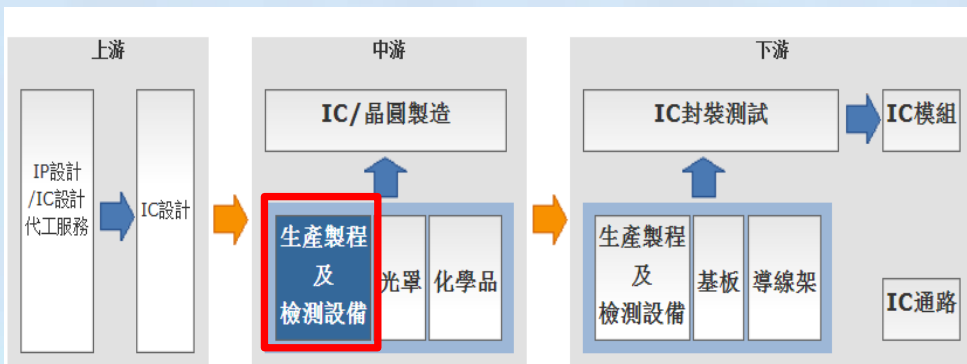
榮獲世界第一大半導體設備製造商「最佳合約製造獎」

2019

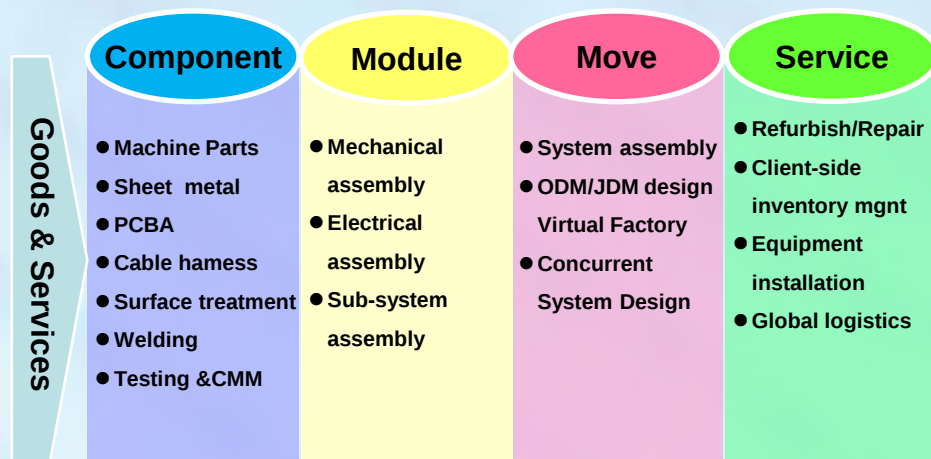
榮獲世界第一大半導體設備製造商「卓越表現獎」(連續3年獲得)

職稱	姓名	經歷	產業經驗
董事長	劉揚偉	鴻海精密工業股份有限公司S次集團總經理 Sharp Corporation董事 富泰康電子研發(煙臺)有限公司董事長	>30年
總經理	邱耀銓	鐸德科技-經理 美商ASYST/PST-經理	>20年
策略長	黃啟智	鐸德科技-董事長兼總經理 美商ASYST/PST-行銷副總	>25年
研發資深副總經理	傅承祖	新普科技董事 國立聯合技術學院-副教授/系主任	>25年
研發協理	黃俊凱	鐸德科技-資深工程師 工研院機械所-副工程師	>20年
製造副總	王盛昌	公準精密-研發經理	>20年
財務長	陳鎮福	喬鼎資訊-財務長 沛鑫能源科技-副總經理 台灣應用材料-主計長	>30年
會計資深經理	鍾曉佩	沛鑫半導體工業 佳邦科技	>15年

半導體前段製程設備



合約製造營運模式



自動化設備



一次購足之整合性解決方案



01



公司簡介

02



競爭優勢及發展策略

03



營運實績

製造服務中心

- 生產供應設備耗材及維修備品零件
- 進行設備系統及模組之維修保養
- 零件耗材之物流運籌管理

技術服務中心

- 組裝與調校精密半導體設備
- 生產精密、高潔淨度半導體設備零組件
- 進行半導體設備等級精密表面處理

設備研發中心

- 半導體晶圓廠自動化設備設計開發能力
- 與國際接軌進行高端設備共同開發

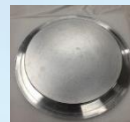
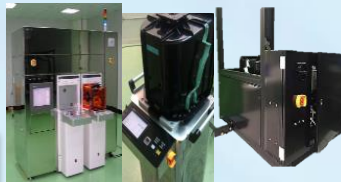
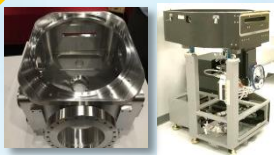
關鍵備品耗材服務

設備維修翻修服務

晶圓廠微污染防治解決方案

模組整合製造

關鍵零組件



半導體設備
生命週期製造服務

半導體廠自動化
設備自主研發

醫療設備開發及
製造服務

設備及關鍵部件
再生循環經濟

- 晶圓移載搬送自動化
- 先進製程微污染防治方案
- 氮氣倉儲系統
- 自動晶圓外觀檢查
- 晶圓AOI檢測設備

- 醫療設備關鍵零組件
- 智慧醫療周邊設施
- 放射治療設備
- 醫療影像診斷設備

- 半導體資本設備新機生產
- 蝕刻/薄膜製程腔體模組
- 真空傳送平台模組
- 真空腔體及精密零組件
- 太陽能電池芯片設備

- 關鍵製程備品耗材
- 關鍵製程設備翻新

佈局四大產品領域 深耕核心技術

01



公司簡介

02



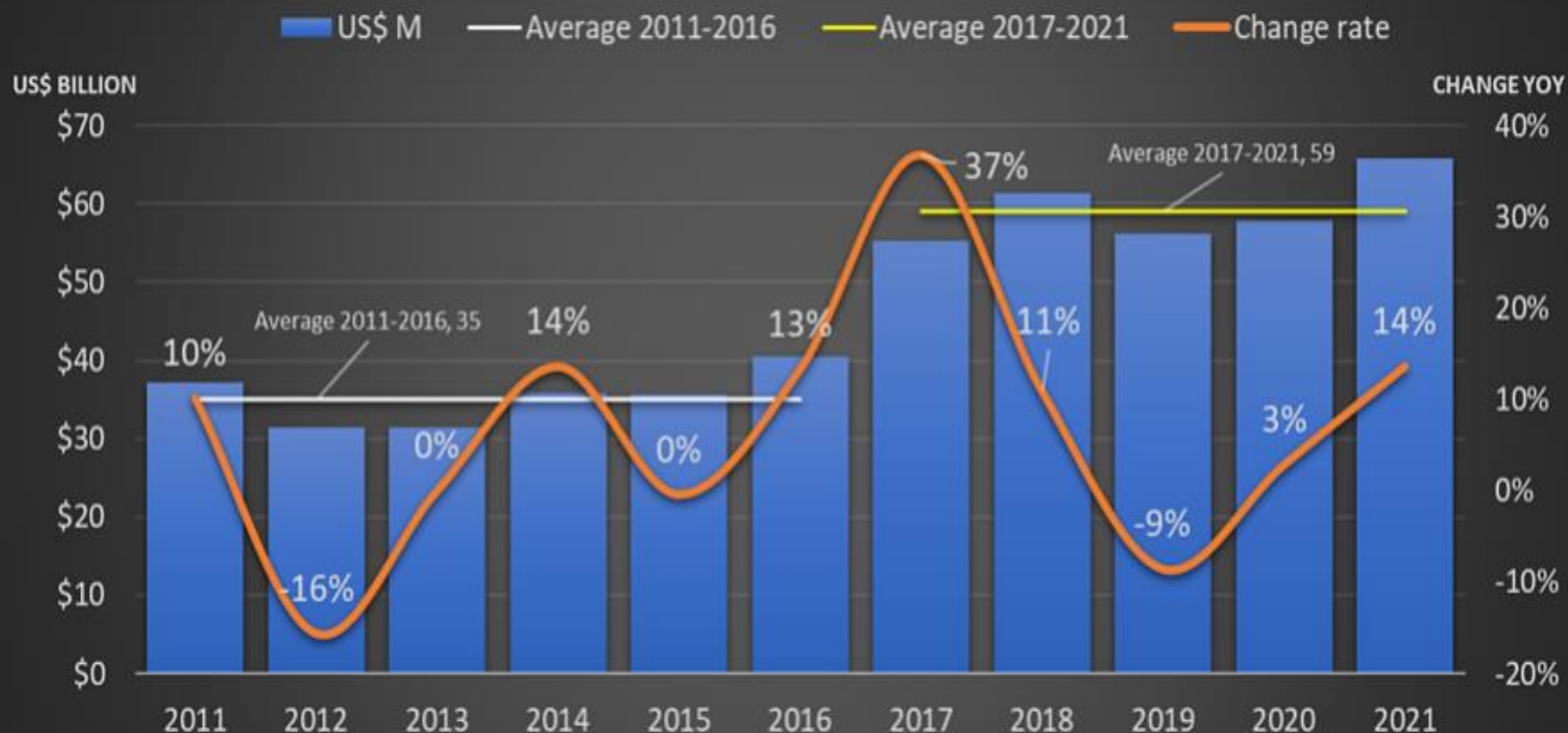
競爭優勢及發展策略

03



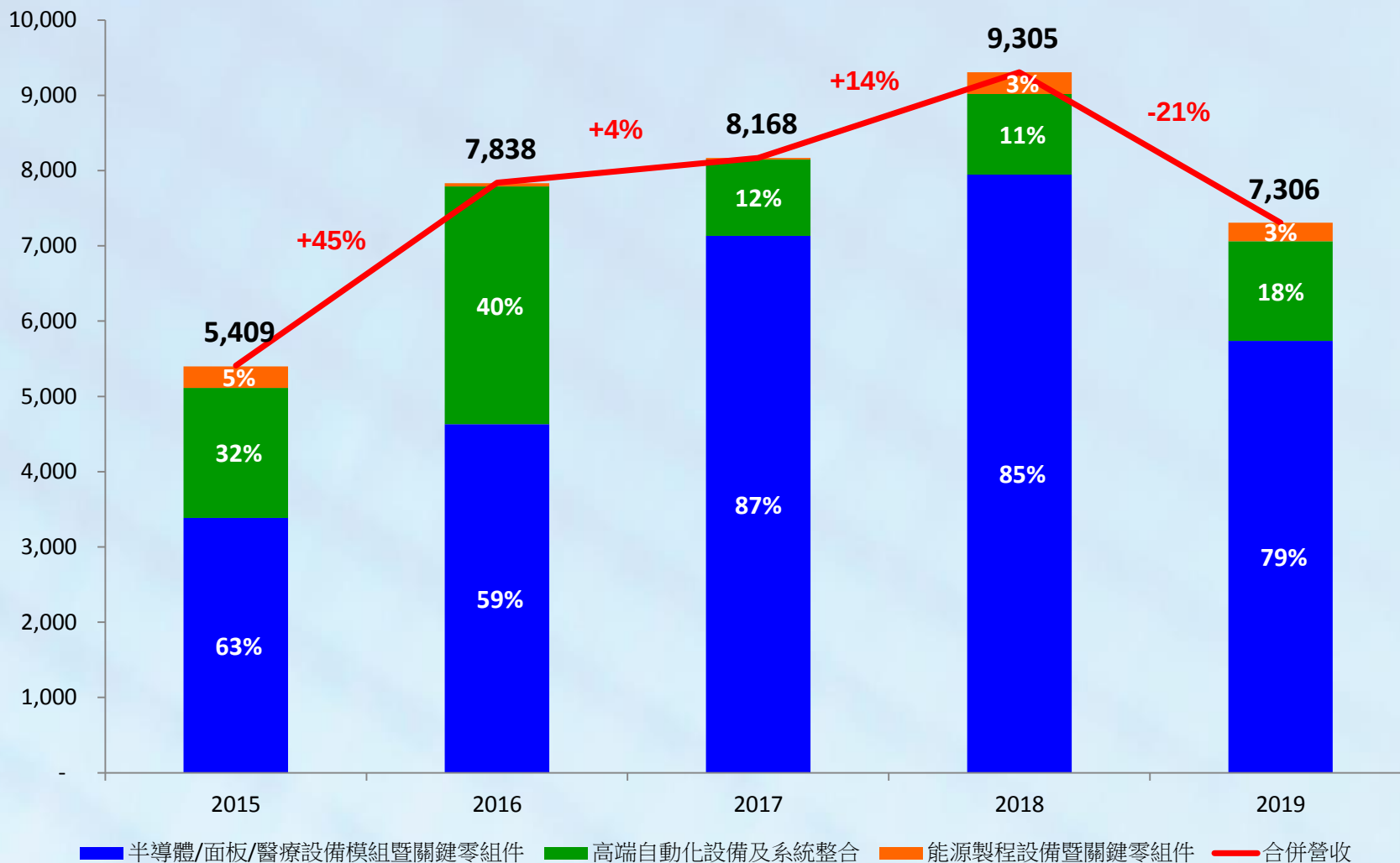
營運實績

Fab Equipment Spending

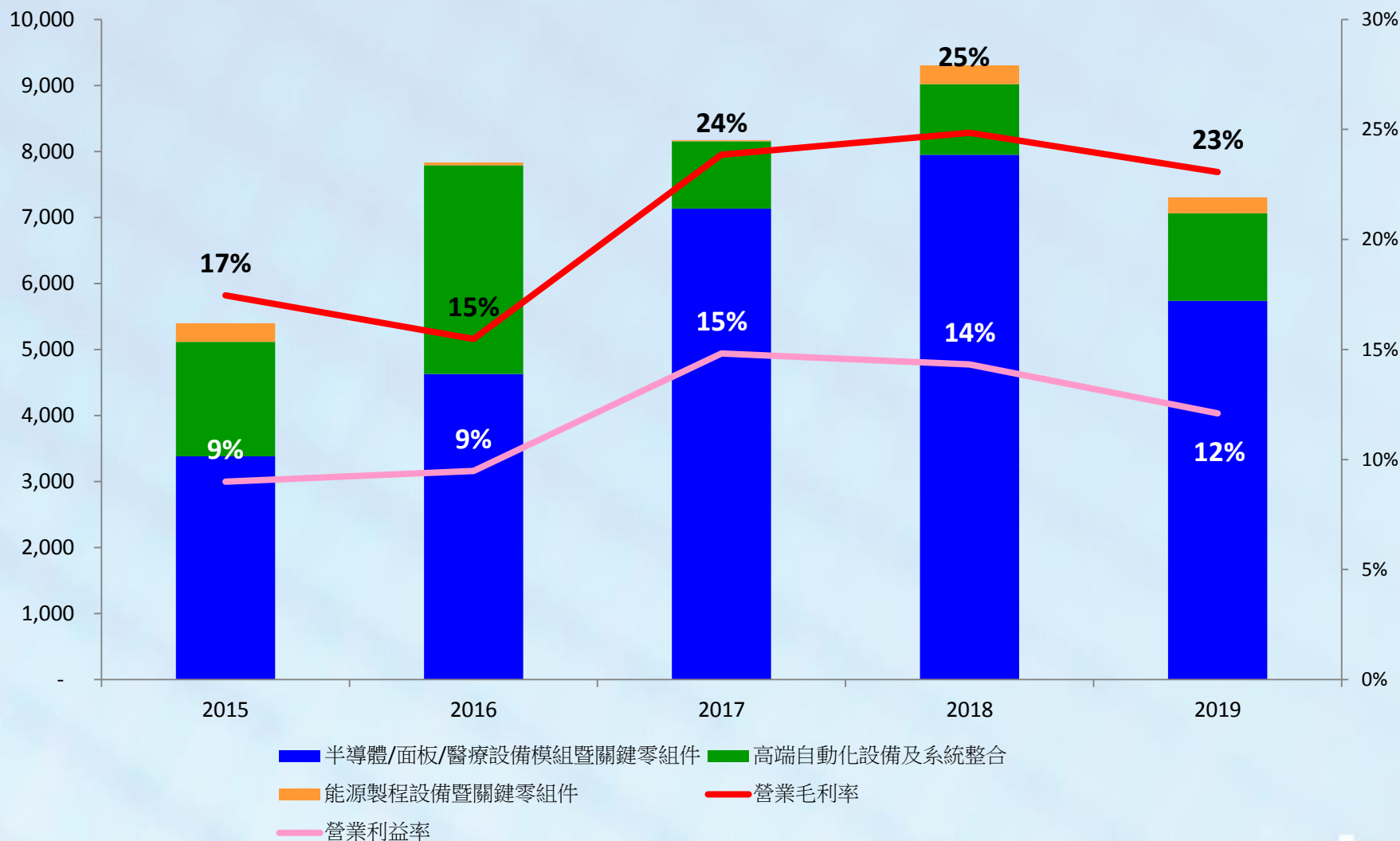


SOURCE: WORLD FAB FORECAST REPORTS, 1Q20 UPDATE, PUBLISHED BY SEMI

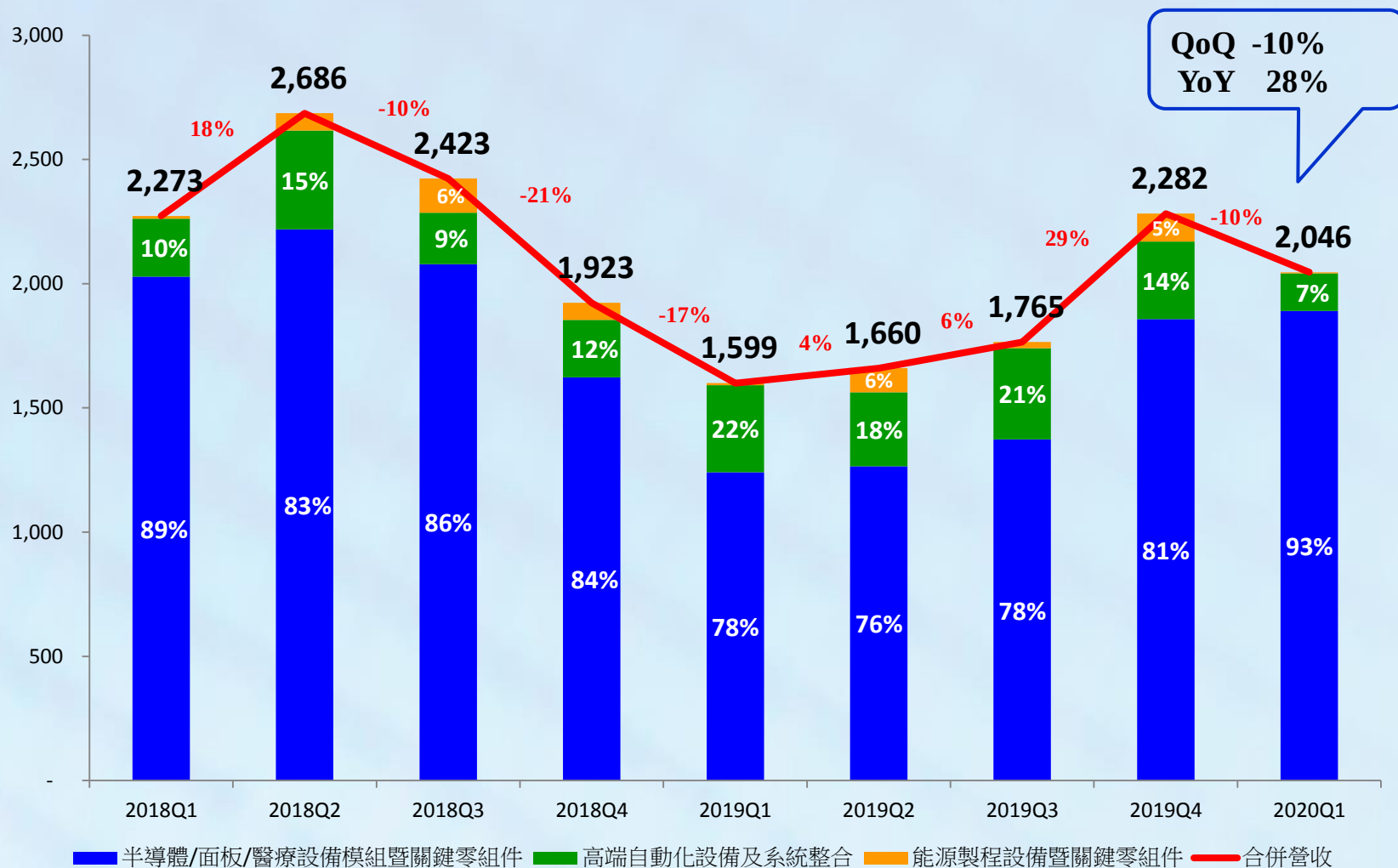
單位：百萬



單位：百萬



單位：百萬



註：2020Q1合併營收數字為本公司會計自結數，正確數字仍需以會計師查核報告為準。

(新台幣仟元)	2019Q1-Q4	2018Q1-Q4	YoY
營業收入	7,305,825	9,304,949	-21 %
營業毛利率	23%	25%	-2 pts
營業費用	(801,053)	(979,437)	-18%
營業淨利	883,801	1,332,640	-34%
營業淨利率	12%	14%	-2 pts
營業外收入及支出	(85,942)	100,435	-186%
稅前淨利	797,859	1,433,075	-44%
稅前淨利率	11%	15%	-4 pts
所得稅費用	(150,593)	(270,414)	-44%
本期淨利	647,266	1,162,661	-44%
本期淨利率	9%	12%	-3 pts
每股盈餘(元) ^註	7.85	14.06	-44%
加權平均流通在外股數(仟股)	82,688	82,688	

註：每股盈餘業經追溯調整盈餘轉增資配股之影響

Unit: NT\$

Year	2015	2016	2017	2018	2019(註)
EPS (Before stock dividends)	8.11	9.05	13.63	14.06	7.85
Cash DPS(NT\$)	4	4	6	7	4
Stock DPS(NT\$)	-	0.5	0.5	-	-
Total	4	4.5	6.5	7	4
Payout ratio(%)	49%	50%	48%	50%	51%

註：2019盈餘分配已經過2020/3/11董事會同意，尚待2020/5/28股東會決議



■ 新冠肺炎疫情因應

- 京鼎於2020/1/26正式成立防疫小組，由總經理擔任指揮官。

- 大陸廠區自2/10復工，截至3月中大陸廠區已全面復工。

■ 京鼎公司竹南二廠擴產廠房設計案送審。

■ 京鼎公司董事會擬定每普通股配發4元現金股利，並核准於5月28日舉行2020年股東常會。

■ 京鼎公司董事會已通過下一屆董事候選名單，現有董事與獨立董事全部留任。

■ 審慎樂觀看待第二季業績展望。

Thanks for your attention.

京鼎精密科技股份有限公司
Foxsemicon Integrated Technology, Inc.

先進設備科技 整合領航者